

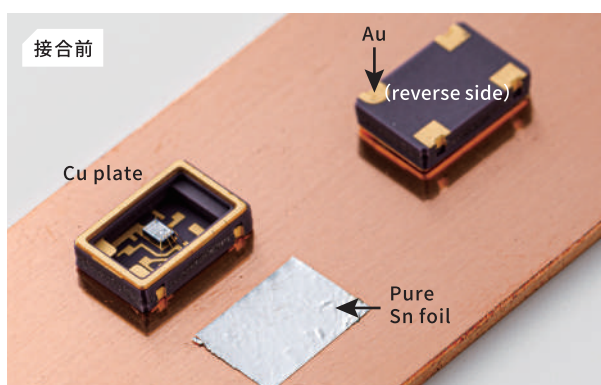


Application

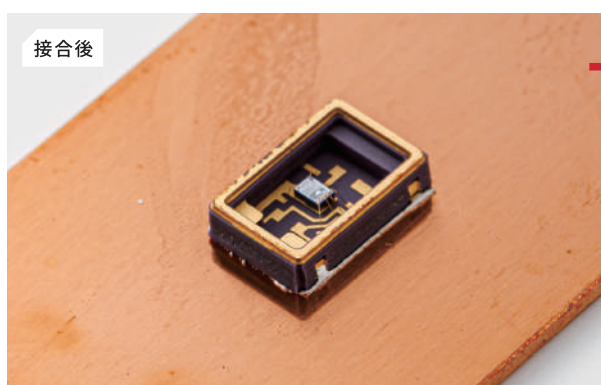
Bonding ボンディング

電子部品と銅板の接合

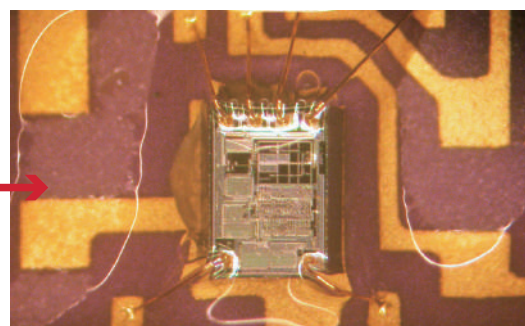
パーツにダメージがない接合と洗浄



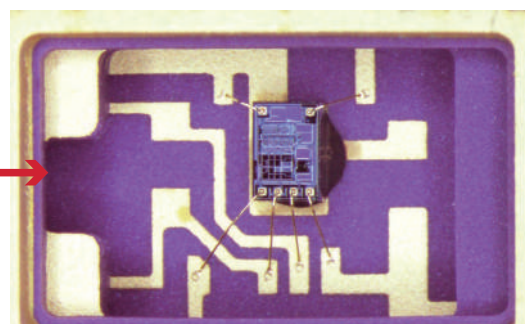
純スズ箔を挟んだ〈SAW フィルターと銅板〉の接合



スズが拡散し〈接合〉 直接接合でも可能



アルテックスの装置で洗浄しても
パッケージにダメージが発生しない



金線の断線無し

IC パッケージ
サウンドパワーでは慣性が発生しないので
パーツにダメージも発生しない

Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0104A4-2021101501